

檔 號：

保存年限：

## 台灣發明商品促進協會 函

機關地址：105台北市松山區八德路二段  
400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國111年4月9日

發文字號：世發聯字第1110040903號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件一 1110040903\_Attach1.docx、附件二 1110040903\_Attach2.pdf)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2022日本真夏設計創意暨發明展」。

說明：

- 一、「2022日本真夏設計創意暨發明展」將於111年7月1日~7月3日在東京舉行，這是青年發明家和新銳設計師，促進國際交流與商業合作的最佳平台，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 二、即日起報名至111年5月31日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、稻江科技暨管理學院、國立臺南藝術大學、國

國立中興大學

第1頁，共7頁  
線上簽核文件列印 - 第2頁/共8頁



1110006141 111/04/11

立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本： 11/04/11 08:29:17

施養隆 會長

• 裝

訂

線

第2頁，共7頁  
線上簽核文件列印 - 第3頁/共8頁

[在此鍵入]



World Invention  
Intellectual Property  
Associations

## 2022 日本真夏設計創意暨發明展 報名表



|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 連絡單位               | 中文名稱：<br>聯 絡 人：<br>職 稱：<br>連絡電話：<br>電子信箱：                                           |
| 參賽作品               | 中文名稱：<br>英文名稱：                                                                      |
| 參 賽 人<br>(至多 10 位) | 參賽單位：(中文)<br>參賽單位：(英文，印製獎狀)<br>中文姓名：<br>英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同)<br>職 稱：<br>出生縣市：(縣市政府接見) |
|                    | 參賽單位：<br>參賽單位：<br>中文姓名：<br>英文姓名：<br>職 稱：<br>出生縣市：                                   |
|                    | 參賽單位：<br>參賽單位：<br>中文姓名：<br>英文姓名：<br>職 稱：<br>出生縣市：                                   |
|                    | 參賽單位：<br>參賽單位：<br>中文姓名：<br>英文姓名：<br>職 稱：<br>出生縣市：                                   |



[在此鍵入]



**WIIPA**  
World Invention  
Intellectual Property  
Associations

## 2022 日本真夏設計創意暨發明展 報名表

|      |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 專利申請 | <input type="checkbox"/> 已核准號碼_____ (請附專利證書影本)<br><input type="checkbox"/> 申請中案號_____ (請附收據影本)<br><input type="checkbox"/> 尚未申請 |
| 作品屬性 | <input type="checkbox"/> 商品化<br><input type="checkbox"/> 原型<br><input type="checkbox"/> 模型<br><input type="checkbox"/> 圖稿       |
| 作品簡介 | 中文摘要：(不限字數)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>英文摘要：(不限字數)                                                                  |
| 影片連結 |                                                                                                                                 |
| 作品相片 | 3~5 張作品獨照或團隊合作相片                                                                                                                |



[在此鍵入]



World Invention  
Intellectual Property  
Associations

## 2022 日本真夏設計創意暨發明展 報名表

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作品類別<br>(限勾選一項) | <input type="checkbox"/> 農業<br><input type="checkbox"/> 自動化與製造業<br><input type="checkbox"/> 汽車,航天,航空,運輸<br><input type="checkbox"/> 美容,醫藥與運動<br><input type="checkbox"/> 生物技術<br><input type="checkbox"/> 建築與結構<br><input type="checkbox"/> 兒童照護與特殊照護<br><input type="checkbox"/> 教育<br><input type="checkbox"/> 環境與能源<br><input type="checkbox"/> 設備,電子產品與機械<br><input type="checkbox"/> 家用品與辦公用品<br><input type="checkbox"/> 通訊技術與視聽設備 | <input type="checkbox"/> 工業設計<br><input type="checkbox"/> 時尚設計<br><input type="checkbox"/> 商業設計<br><input type="checkbox"/> 多媒體設計<br><input type="checkbox"/> 室內設計<br><input type="checkbox"/> 印刷包裝設計<br><input type="checkbox"/> 建築設計<br><input type="checkbox"/> 景觀設計<br><input type="checkbox"/> 模型設計<br><input type="checkbox"/> 視覺傳達設計<br><input type="checkbox"/> 工藝設計 |
| 參展目的            | <input type="checkbox"/> 廣告曝光<br><input type="checkbox"/> 現場販售<br><input type="checkbox"/> 技術移轉<br><input type="checkbox"/> 代理合作<br><input type="checkbox"/> 批發合作<br><input type="checkbox"/> 製造合作<br><input type="checkbox"/> 個人履歷                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 注意事項            | 1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔<br>2. 海報尺寸：大會尚未公布<br>3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw<br>4. 連絡電話：02-8772-3898<br>5. 截止日期：2022 年 5 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 匯款資訊            | 台灣發明商品促進協會<br>元大銀行營業部<br>00108253826215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## 2022 第 9 屆日本真夏設計創意暨發明展

### JDIE

### 邀請函



2022 第 9 屆日本真夏設計創意暨發明展由株式会社知財コーポレーション及世界發明智慧財產聯盟總會共同籌劃主辦，將於 7 月 1 日至 7 月 3 日在東京著名的 Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake 會議展覽中心舉行為期 3 天的展覽、交流及頒獎儀式。

日本的創意及設計引領風騷，在亞洲極具指標，其發明更是處處蘊藏巧思，令人驚艷。日本設計與發明一直被大眾奉為圭臬，並且擁有強烈的文化特色，許多視覺會讓人不禁說出「日本風格」這樣的感受。



日本真夏設計創意暨發明展，跳脫制式的展覽框架，主辦單位創造一個「無限制」讓您盡情發揮的舞台，參展者可以用任何方式展現你的作品。參展的項目除了設計及發明、科技之外，並囊括繪畫、藝術、創意表演等。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請台灣發明家參與此盛會，讓台灣的發明創意在全世界發光發亮。



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗  
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀



## 2022 第 9 屆日本真夏設計創意暨發明展

### JDIE

主辦單位：株式会社知財コーポレーション、WIIPA

展覽日期：2022年7月1日~7月3日

展覽地點：Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake會議展覽中心

參展費用：45,000/件，包含10位發明人報名費、展位費、桌椅、評比費。

選購品項：3,000 元/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000 元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

參展效益：參展增加商品曝光度及個人閱歷，更是升學就業的加分利器。展後協會安排縣市政府接見及頒發獎狀。

報名資訊：台灣發明商品促進協會（TIPPA）

截止日期：2022年5月31日

協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F（添盛大樓）

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215

